

证券代码：000021

证券简称：深科技

## 深圳长城开发科技股份有限公司

### 2021年05月13日投资者关系活动记录表

编号：2021-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	灏浚投资、深圳市麦高富达基金管理有限公司、中国中金财富证券有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、深圳市瑞智通投资管理有限公司、深圳市瑞智通投资管理有限公司、深圳市麦迪逊广告有限公司、东莞市鼎太电器有限公司、国泰君安、合众资产、招商证券、蔷薇资本有限公司、华安财产保险股份有限公司、上海业如天建管理有限公司、圆石投资、亿库投资、杨文、王瑜
时间	2021年5月13日 15:00—17:00
地点	深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所8楼
上市公司接待人员姓名	董事长周剑先生、副总裁兼财务负责人莫尚云先生、副总裁周庚申先生、董事会秘书李丽杰女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为加强央企控股上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩、经营情况，深科技根据实际控制人中国电子信息产业集团有限公司统一安排，于2021年5月13日在深交所举办2020年度现场业绩说明会，主要情况如下：</p> <p>一、公司副总裁就2020年度工作回顾、业绩情况和未来发展等方面与会投资者进行了介绍，并回复广大投资者普遍关注的问题，具体如下：</p> <p>1、经营业绩情况</p> <p>2020年度，公司聚焦全球的行业龙头客户资源优势，加大国内外市场</p>

开拓力度，携手战略合作伙伴在合肥投资建厂扩充产能；利用自主研发创新优势，持续开拓计量系统产品的全球业务版图；聚集高端制造规模化制造和跨区域布局优势，配合医疗器械客户完成强劲的订单需求，并积极寻求新能源汽车电子、智能产品、数据存储、新能源等新兴行业成长机会，不断深化与国内外优质客户的合作。公司主营业务收入逆势增长，实现营业收入149.67亿元，同比增长13.18%；归属于上市公司股东的净利润8.57亿元，同比增长143.30%。

## 2、公司未来发展战略

深科技是全球领先的EMS专业提供商，在电子产品制造领域拥有逾三十年的技术沉淀和工程制造经验积累，有完善的精细化管理体系，有国际化的管理团队和海外网络，是业内国际化大客户的核心供应商和战略合作伙伴，规模优势及资源优势明显。目前形成聚焦发展半导体封测及模组、高端制造、自有品牌（以计量产品为主）三大产业领域的发展模式。深科技未来将面向国内国际两个市场形成相互促进的新格局，着力打造国内国际竞争新优势，以国际化视野，围绕大客户发展方向和需求强化海内外研发、生产、制造的联动布局。

## 3、合肥半导体投资项目

深科技顺应国家半导体战略，助力国内存储器厂的快速发展。合肥沛顿存储注册资本30.60亿元，深科技全资子公司沛顿科技、大基金二期、合肥经开投创和中电聚芯分别出资17.10亿元、9.50亿元、3亿元和1亿元，依次持股55.88%、31.05%、9.8%、3.27%，深科技拥有绝对控股权。本项目实施后，可满足客户较大需求的DRAM、Flash存储芯片封测以及DRAM内存模组制造业务，有助于国内存储器芯片封测的深度国产化，提升国产存储芯片封测的产业规模，促进我国存储器产业链发展。

## 4、重组整合通讯与消费电子业务

因应全产业链整合趋势需要，深科技引入桂林高新集团，领益制造等外部投资者，以桂林公司为平台整合公司通讯与消费电子业务，强强联合，提高业务综合竞争力。

## 5、面对新冠疫情公司采取的应对措施

自疫情发生以来，公司将疫情防控作为工作的第一要务。深科技管理层持续关注疫情发展对企业生产的影响，超前部署、系统安排，全面构筑抗击疫情“防火线”，确保防控到位的前提下坚持生产不间断。与此同时，深科技无数“逆行者”始终坚守在生产一线。春节期间，苏州、沛顿、精密三家公司近1387员工在严密措施的保护下安全稳定生产；为保障物资供应，公司采购部千方百计在全球寻找紧缺物资；安全管理办公室严格执行每天隔离消毒例行消杀防疫，坚持体温检测，加强外来人员管理；党群工作部出台各项举措凝心聚力、稳定员工；穿着红马甲的志愿者们穿梭在食堂、园区；为保障项目顺利开展，一批批“奋斗者”远渡重洋坚守项目建设现场。

## 二、互动回答环节的内容如下：

1、2020年，公司与地方政府共同投资建设了集成电路先进封测和模组制造项目合肥沛顿。请公司介绍该项目的进展情况，并结合存储半导体封测市场未来发展空间介绍该项目的战略前景以及对公司经营业绩的未来影响。

合肥沛顿为公司与大基金二期和地方政府共同投资建设集成电路先进封测和模组制造项目，该项目总投资100亿元，主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务。其中一期项目投资30.67亿元，公司已公告通过非公开发行募资资金与国家集成电路大基金二期、合肥经开创投、中电聚芯等共同投资完成，包括新建月均产能4800万颗DRAM存储芯片封装测试的项目、月均246万条存储模组项目和月均产能320万颗NAND Flash存储芯片项目。

目前合肥沛顿项目建设进展顺利，一期厂房6月底封顶，并于12月投入生产并形成有效产能，届时可全面配合上游厂商最新的业务发展进度。

## 2、深科技沛顿在封测方面是否掌握核心技术？

深科技8Gb/16Gb DDR4已通过了国内外多个大客户的验证正式交付，目前公司在存储封测17nm量产基础上，持续推进更精密10nm级DRAM产品的技术迭代，不断向全球DRAM市场的主流工艺节点技术进行突破。深科技目

前的封测技术能够覆盖主流存储器产品，并具备LPDDR3、LPDDR4和固态硬盘SSD的量产能力。同时，在国内外存储芯片向高速、低功耗、大容量发展的行业趋势下，深科技不断推动DDR5、LPDDR5等新产品的技术开发，且具备最新一代DRAM产品的封测能力。

### 3、沛顿今年和未来如何满足客户产能需求？

公司封测业务一直处于满负荷生产状态，为满足客户业务持续增长需求，沛顿的产能也在持续扩张中。

目前封测客户业务主要集中在深圳园区生产，随着客户产能提升，公司持续进行相应的厂房扩建和设备投资，以满足客户产能快速提升的需求，未来相关项目建成后，将可满足国内外市场高性能存储芯片未来发展及客户新增产能持续扩张需求，进而打造公司集成电路半导体业务的长远竞争力。

### 4、公司硬盘业务未来规划如何？

在硬盘数据存储业务领域，公司拥有36年的业务历史，掌握硬盘磁头与硬盘盘基片核心制造技术，拥有自主知识产权的全自动高精密头堆、盘基片生产线，主要产品包括硬盘磁头、盘基片、HDD机械硬盘、SSD固态硬盘。目前机械硬盘在大型计算机、安防系统等容量存储及数据安全领域有突出优势，公司硬盘存储业务市场前景将持续向好。未来公司将充分利用强大的研发创新优势，先进的智能制造能力，深厚的行业资源及良好品牌口碑优势，不断调整和优化产品结构，积极把握数据中心的发展机遇，引入存储服务器、固态硬盘等新业务，拓宽业务布局。

### 5、问：深科技城市建设如何？

答：公司在建项目“深科技城”定位于“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体，开发建设用地面积4.38万平方米，计容积率建筑面积为26.3万平方米，另可在地下开发1.6万平方米商业用房。目前一期将建有3栋产业研发用楼和商业建筑，现工程建设正按计划

	<p>有序推进中，其中C座已完成封顶，该项目在满足自用的前提下将以出租为主，届时将为公司带来更为充沛的现金流。</p> <p>6、请介绍公司自主产品情况？</p> <p>得益于20多年营销、研发、生产、供应链管理 &amp; 品质管控能力的丰富经验，公司已为全球33个国家，80余家能源公司提供智能计量产品及端到端的整体解决方案服务，其中主站系统已部署超过10个国家，可容纳超1,500万只智能表计设备。凭借先进的技术和专业的服务，行业领先的创新优势和过硬的品质，公司赢得了国内外客户的长期信赖，与欧洲、非洲、亚洲、南美洲地区的多个国家级能源事业单位客户建立稳定的合作关系。报告期内，公司计量系统业务全年出货量相比上一年增加30.4%，全年工序自动化率提高到50%，实现重点项目中关键设备数据采集覆盖率90%。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021年05月13日